

TIG[®]780-50 是一种膏状导热界面材料，专为各类中高功率电子元器件的散热而设计。材料在典型装配压力与微小填充厚度下，可充分润湿接触表面，有效排除界面空气，形成连续热传导路径。该产品可广泛适用于网络通信、安防监控、家用电器及常规工业控制硬件等对成本与性能均有要求的通用电子设备散热场景。



特性

- 》低热阻
- 》高的热传导率
- 》优异的润湿性，能充分浸润接触表面，消除空气间隙
- 》可操作时间长，无毒环保

应用

- 》LED照明
- 》ASIC芯片
- 》CPU、GPU与散热模组界面填充
- 》车载控制单元

TIG[®]780-50 特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	灰色	目视
结构&成份	陶瓷填充有机硅	-
最小界面厚度 (mm)	0.031	-
密度 (g/cm ³)	2.3	ASTM D792
黏度 (mPa·s) @25°C	450000	GB/T 10247
建议使用温度范围 (°C)	-45~200	-
热阻抗 (°C·in ² /W) @30psi	0.013	ASTM D5470
导热系数 (W/m·K)	5.0	ISO22007
体积电阻率 (Ohm·cm)	> 1.0×10 ¹³	ASTM D257
挥发量 (%) @150°C, 24小时	< 0.1	-

